

物料名稱 Commodity	檢查專案 Inspection Item	種類 Classification	驗收標準 Acceptance Criteria
芯片 Wafer	晶片單 Wafer Sheet	主要 Major	全檢，0收/1退 Full Check, 0Ac/1Re
	外觀檢查 Visual Inspection	重要 Critical	全檢，0收/1退 Full Check, 0Ac/1Re
	包裝 Packaging	次要 Minor	全檢，0收/1退 Full Check, 0Ac/1Re
	電性 Electrical	重要 Critical	1片/批，0收/1退 1Waf/lot. , 0Ac/1Re
引線 Lead Frames	裝配效果 Assembling Result	主要 Major	5000粒/批，短,开路数小于 焊线总数 5% 5Kpcs/lot. total of short and open less 5% than bonding wire in a lot.
	包裝 Packaging	次要 Minor	全檢，0收/1退 Full Check, 0Ac/1Re
焊線 Bonding Wire	拉力測試 Pull Test	主要 Major	50粒/批，0收/1退 50pcs/lot. , 0Ac/1Re
	包裝 Packaging	主要 Major	全檢，0收/1退 Full Check, 0Ac/1Re
模料 Molding Compound	注塑效果 Molding Result	重要 Critical	800粒/批，0收/1退 800pcs/lot. , 0Ac/1Re
	包裝 Packaging	主要 Major	全檢，0收/1退 Full Check, 0Ac/1Re